

证券代码：831755

证券简称：邦正科技

主办券商：中信建投

邦正科技股份有限公司 可能触发降层情形的风险全部解除的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 现有层级情况

目前所属市场层级：创新层

进入现有层级时间：2021年6月7日

进层时符合标准情况：

√最近两年营业收入平均不低于6000万元，且持续增长，且年均复合增长率不低于50%，股本总额不少于2000万元。

二、 可能触发降层情形及相关风险解除情况

可能触发降层情形的风险是否全部解除：√是 □否

| 首次出现此项可能触发降层事项的日期 | 可能触发的降层情形 | 相关风险是否已解除 | 风险解除日期 |
|-------------------|--------------------------|-----------|------------|
| 2024年1月8日 | 连续60个交易日，股票每日收盘价均低于每股面值。 | 是 | 2024年1月10日 |

截至2024年1月8日，公司已连续30个交易日股票每日收盘价均低于每股面值。根据《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》第十四条的规定，上述情形连续达60个交易日的，全国股转公司将公司调整至基础层。公司已于2024年1月9日披露可能触发降层情形的风险提示公告。2024年1月10日，公司股票收盘价为1.00元，相关降层风险已解除。

邦正科技股份有限公司

董事会

2024年1月11日